

# GENIDEAS<sup>®</sup>

## 聚賢研發股份有限公司

### 2026年第一季法人說明會

股票代號 **7631**



反省



創新



即時



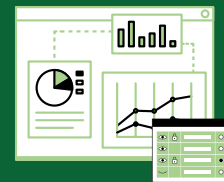
共好

# 免責聲明



- 本簡報相關訊息內容取自於公司內部與外部蒐集之資料，其中包含營運成果、財務狀況、業務發展與產業現況等內容。
- 本公司並未發佈財務預測，本簡報所作有關本公司財務、業務或Q&A之說明，若涉及本公司對未來公司經營與產業發展之見解，可能與未來實際結果存有差異，造成差異之原因可能包括科技演進、市場需求變化、原料價格波動、競爭行為與國際經濟景氣變動等各種風險因素。
- 本簡報內容並非投資建議，本公司不對內容的正確性、完整性或任何使用本簡報內容所產生的損害負任何責任。

# 大綱



01

公司簡介

02

營運策略與研發能力創新

03

創新產品與專利

04

聚賢永續行動

05

業務發展暨財務績效

# 01.公司簡介

**GENIDEAS<sup>®</sup>**



反省



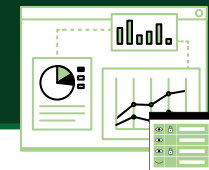
創新



即時



共好



經營團隊

董事長 曾國強 | 總經理 鄭惠芸



公司成立

**2018年1月**



上市日期

**2025年3月13日**



全球員工人數

**170人**



資本額

**NTD 2.01億**



## 廠務工程

- 高科技廠房MEP機電工程
- 高科技廠房整合二次配系統裝機工程
- 高科技廠房氣體供應系統設計施工工程



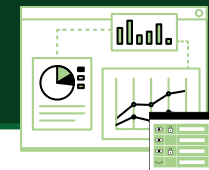
## 設備及零組件 設計開發

- 管路工藝流程優化，機構及輔治具開發
- 製程設備零組件及耗材設計開發
- 全方位售後服務與技術支持



## 跨領域技術 整合創新應用

- 半導體雷射技術延伸應用
- 自動化與智慧製造整合
- 客製化技術解決方案



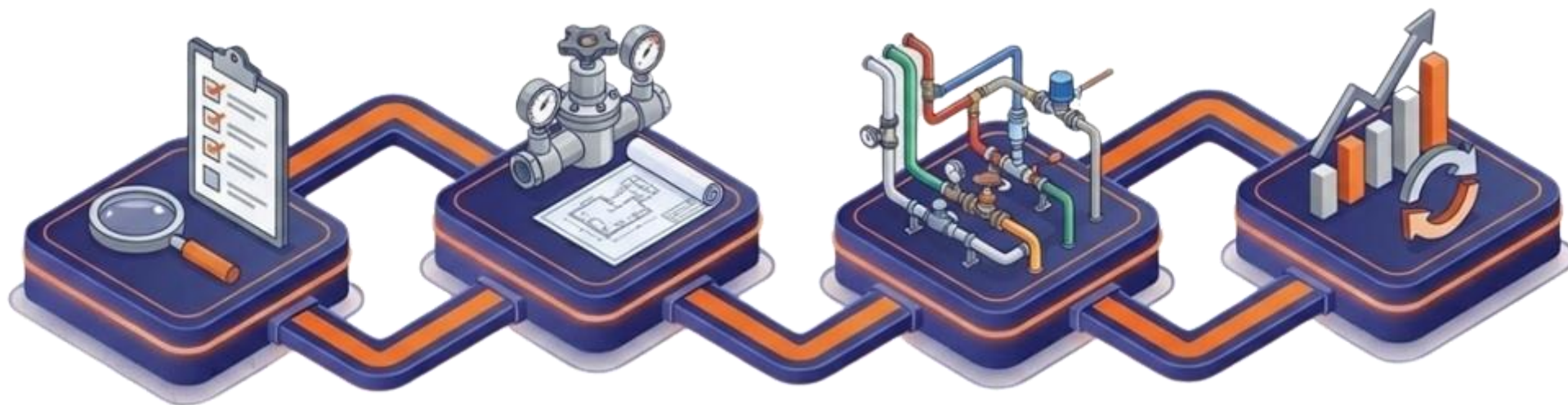
## 跨領域關鍵技術服務與創新產品

從使用者需求  
與問題出發

製程設備所需  
零組件耗材  
設計開發製造

高科技廠房  
MEP機電  
供應系統領域佈局

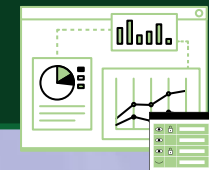
全方位  
售後服務  
技術支持



創新優化客戶生產流程及設備

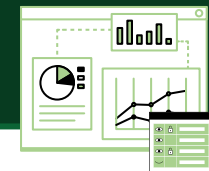
引導改良氣體二次配工程施工作



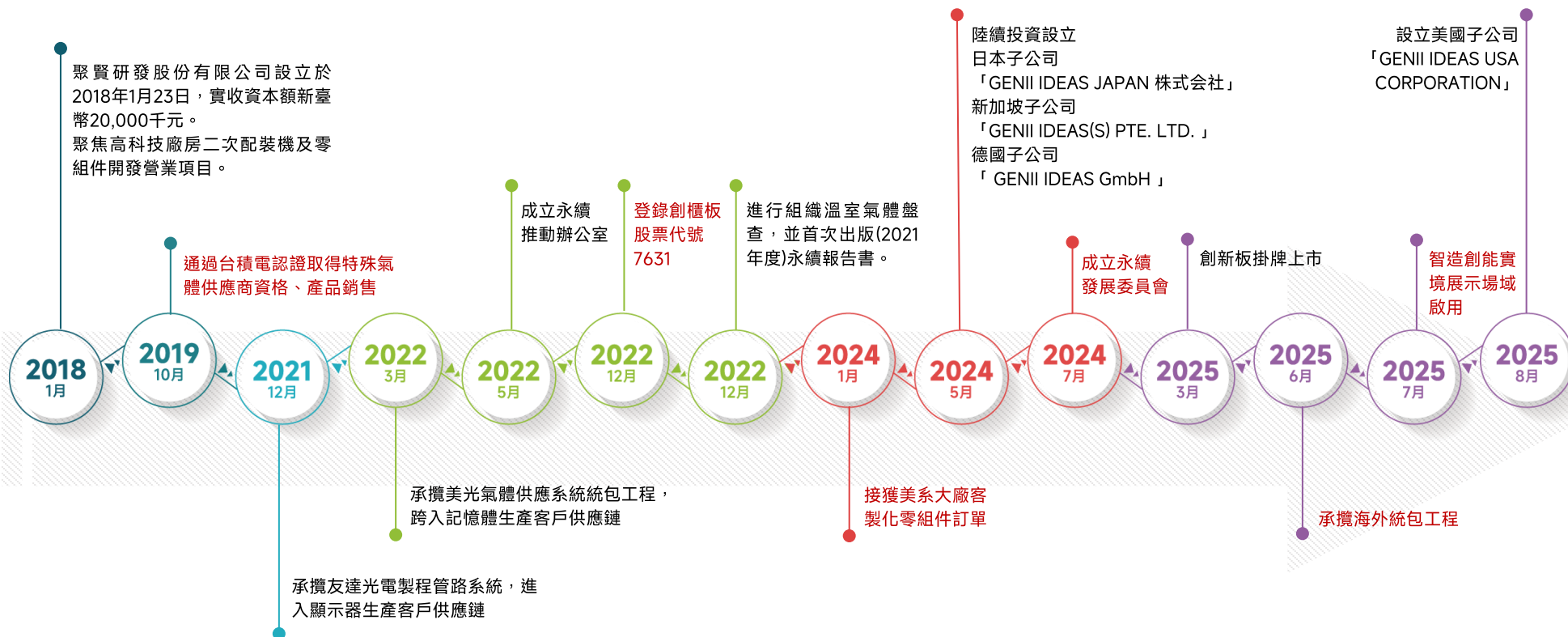


因應氣候變遷及行動下

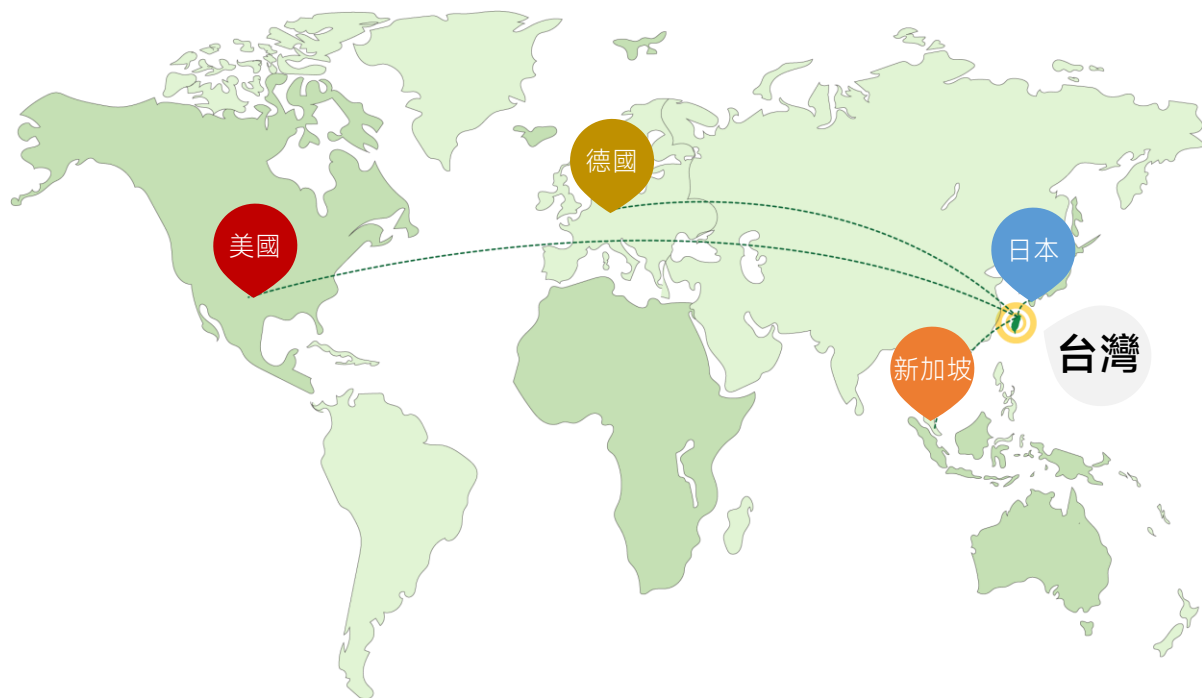
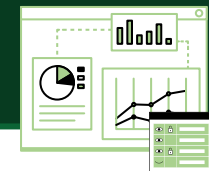
「高科設備優化最佳服務商」



## 公司經營重要歷程

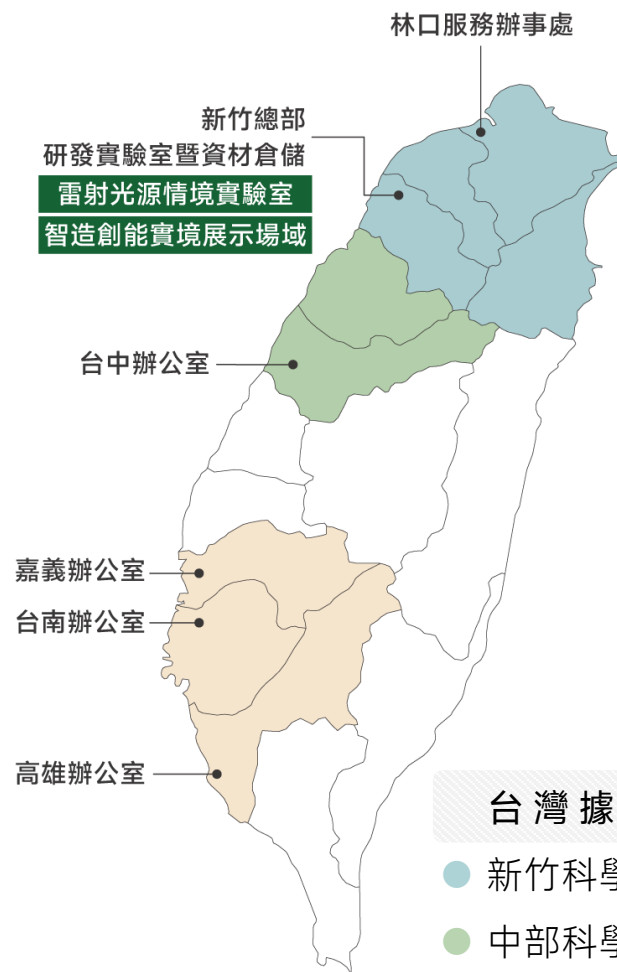


# 全球服務據點



## 海外子公司

- 日 本：熊本
- 德 國：德勒斯登
- 新加坡
- 美國：亞利桑那 (Arizona)

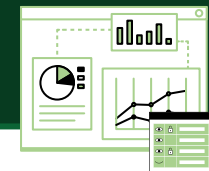


## 台灣據點

- 新竹科學園區
- 中部科學園區
- 南部科學園區

# 02. 營運策略與研發能力創新





## 整合智慧農業與智慧建築，打造零碳排生態圈

### 智慧農業 | 低碳自供電型溫室

攜手工研院

### 農電共生

將鈣鈦礦技術導入沙崙綠能示範場域的溫室

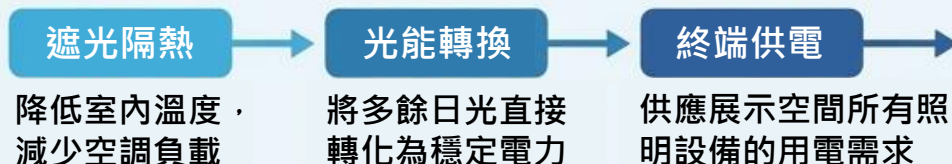
- ✓ 實現高經濟作物的低碳與綠能生產
- ✓ 溫室自主供電，有效降低農場整體消耗
- ✓ 提升科技農業競爭力，邁向2050淨零碳排目標

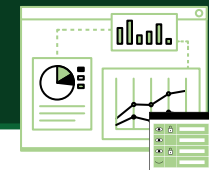


### 智慧建築 | 鈣鈦礦創能門窗

### 從「展示」走向「日常資源循環」

聚賢 SHOWROOM 落地窗升級，讓建築主動參與發電節能





## 資源循環與低碳製程

### 氣體回收、純化與再利用



再生能源



氫氣

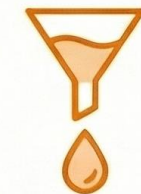


氦氣

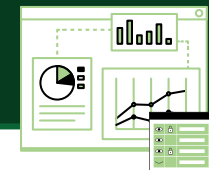


針對再生能源、氫氣及氦氣進行回收處理，轉化為可重複利用的資源。

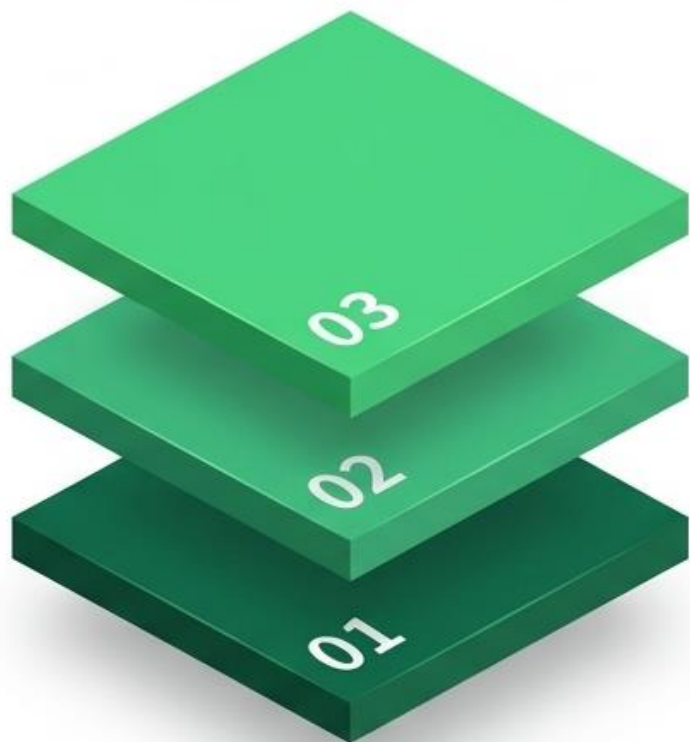
### 超臨界 CO<sub>2</sub> 清洗與萃取



運用超臨界 CO<sub>2</sub> 流體特性，執行高效率的零件清洗或材料成分萃取。



## 建立關鍵技術堆疊優勢



### 跨領域不同場景技術應用

雷射光學 材料科學 自控領域 機械加工

多重技術堆疊大幅提高模仿難度

### 綜合軟硬體整合能力

無縫串聯底層硬體與控制系統，提高產品服務綜效

### 自主研發綠色多元產品

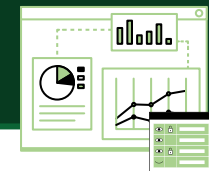
節能減碳 材料輕量 全循環回收

全面對齊淨零策略，實質優化客戶端流程效率

# 03. 創新產品與專利



# 創新產品-管路自動雷射焊接系統



## Genii LaserWelder 全方位雷射焊接系統：從細管到大管的全效解決方案



**智慧大腦：**  
人機介面控制器  
(HMI Controller)

直觀圖像介面，參數  
設定與即時監控



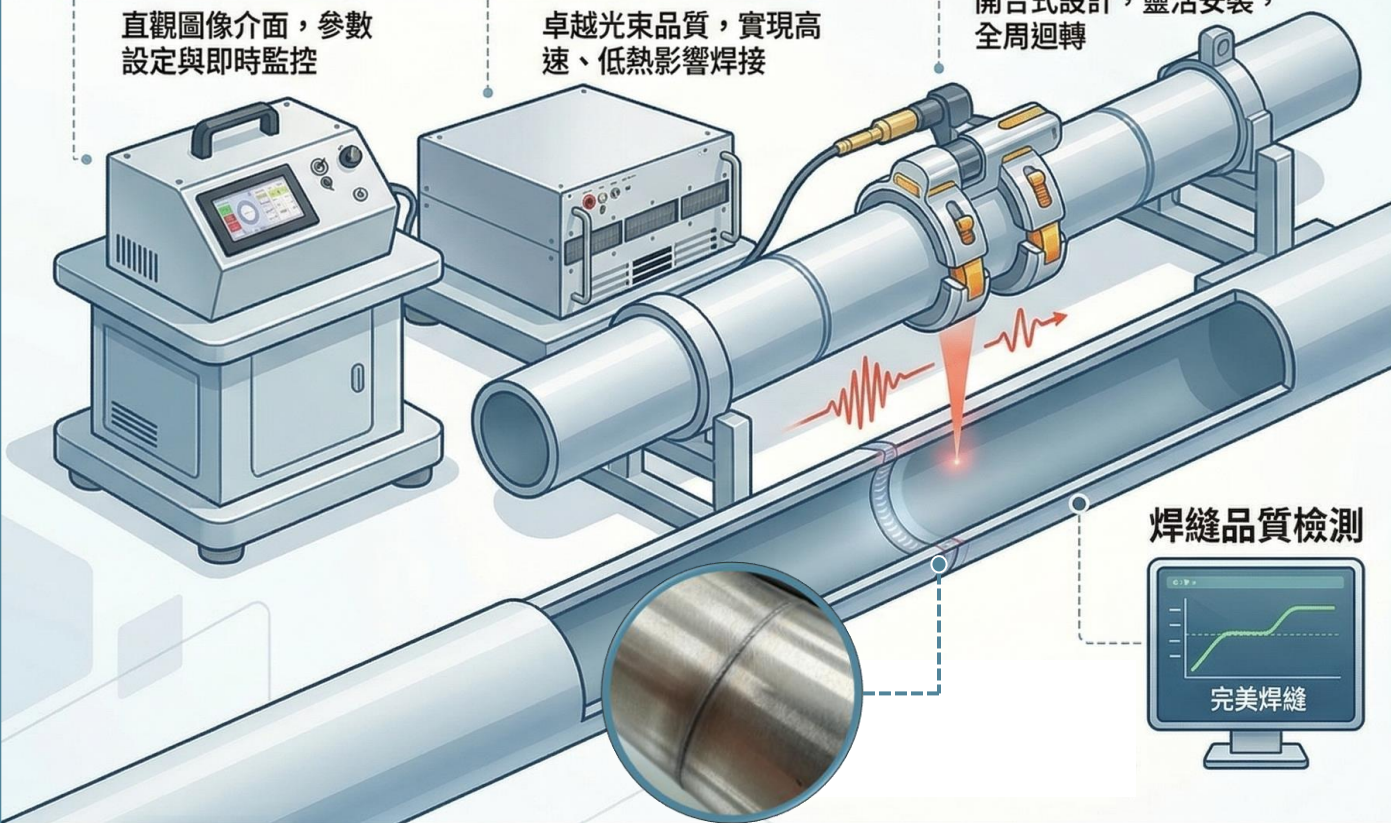
**能量心臟：**  
500W 光纖雷射主機  
(Fiber Laser)

卓越光束品質，實現高  
速、低熱影響焊接



**精準之手：**  
自動化雷射焊把總成

開合式設計，靈活安裝，  
全周迴轉



焊縫品質檢測



### F-Type (細管小徑)



管徑：6A - 25A (1/8" - 1")  
應用：半導體高純度氣體系統  
特色：輕巧靈活

### E-Type (中管中徑)

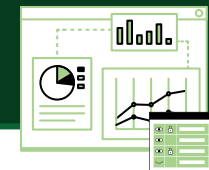


管徑：32A - 100A  
應用：半導體製程真空系統  
特色：精準雷射續接技術

### G-Type (大管大徑)



管徑：100A 以上  
應用：石化、化工、能源產業  
特色：大型管路客製化



## 極細微金屬切割

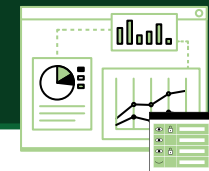


## 電性量測



## 雷射玻璃精密加工





## 管路抗結晶震動裝置：雙效解決方案

### 核心痛點與創新對策

客戶痛點：製程管路結晶堵塞



傳統加熱方式效果有限，  
且較為耗能。

雙效解決方案：  
震動延緩結晶+聲波即時偵測

### 管路抗結晶震動裝置

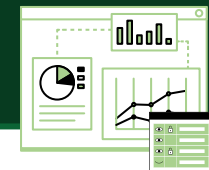
採用夾持式設計，不影響  
既有管線，易於安裝。

功能一：機械震波，有效延緩結晶

通過加嚴高強度耐久測試，  
證實可剝離模擬結晶。

功能二：聲波分析，即時監測堵塞

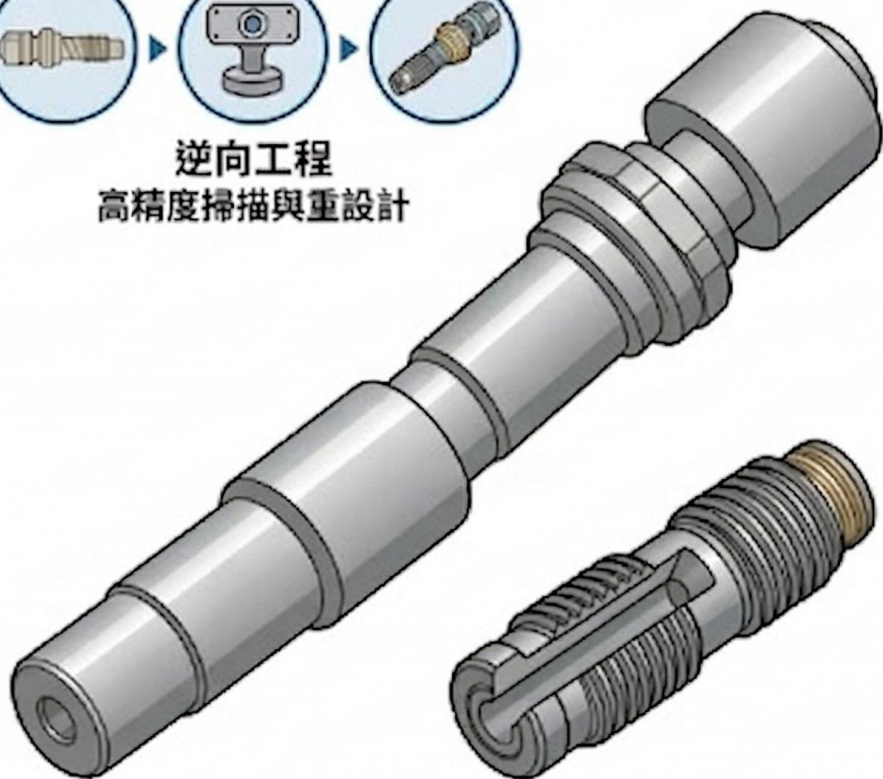
將堵塞程度轉為可視化百分比，  
建議安裝於堵塞點±50公分內。



## 1. 半導體設備固定PIN



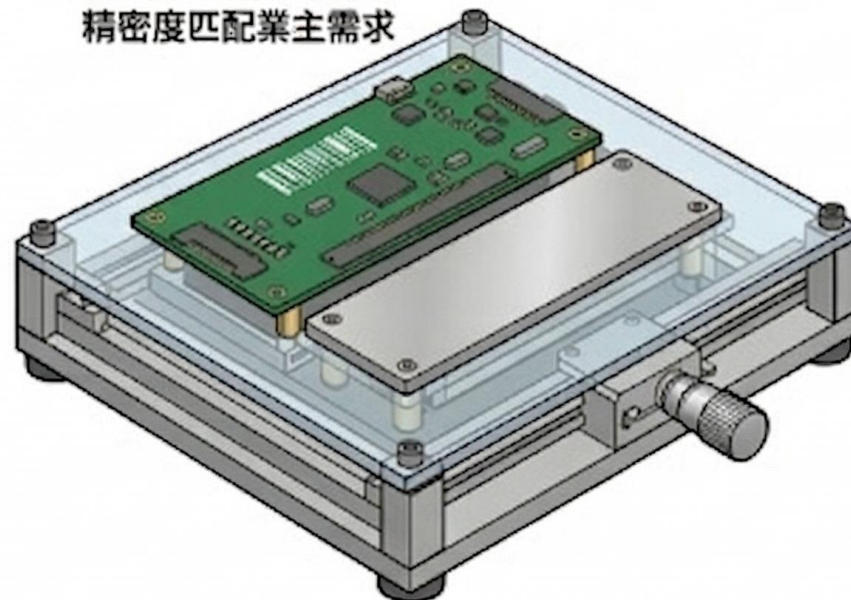
逆向工程  
高精度掃描與重設計



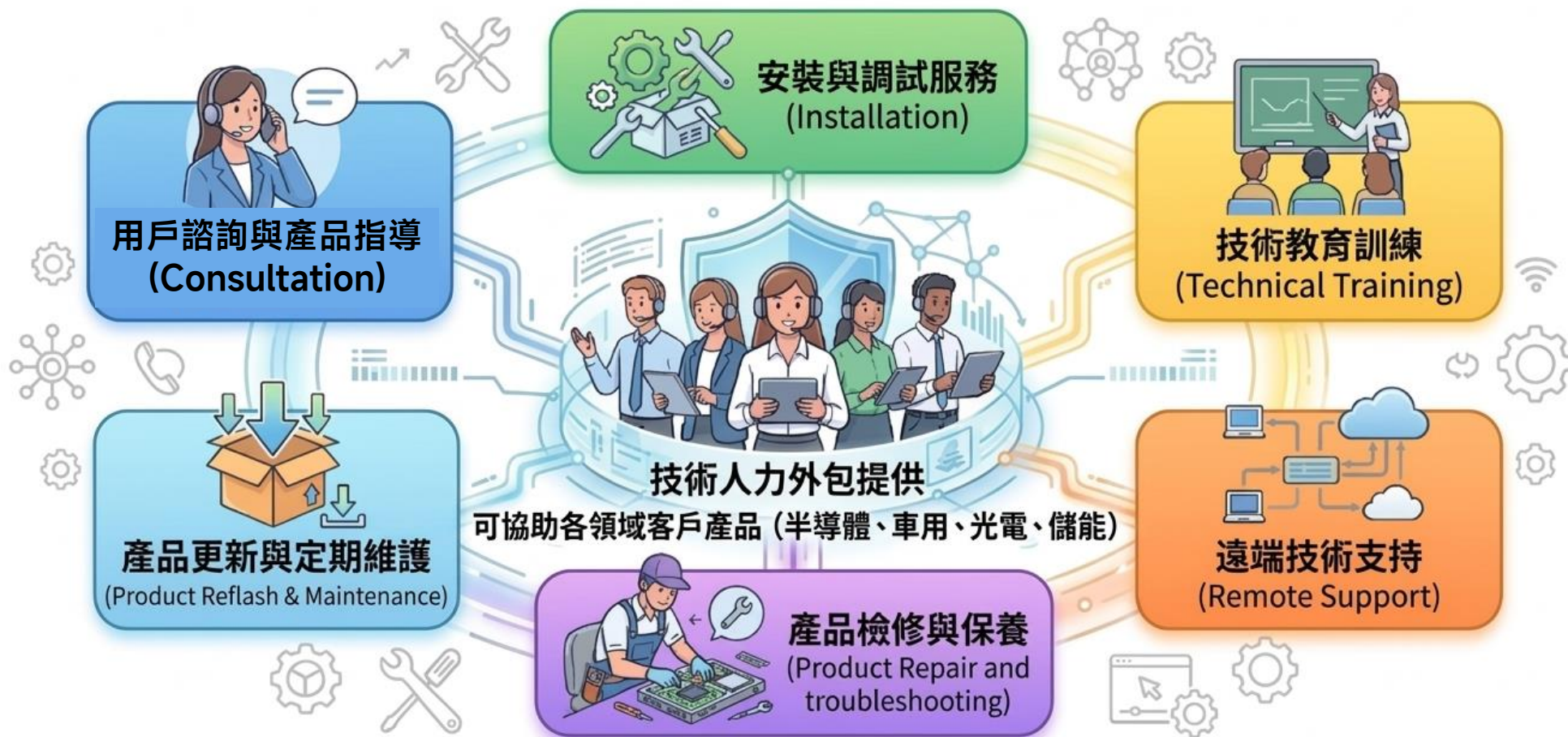
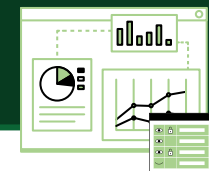
## 2. PCB板量測治具開發



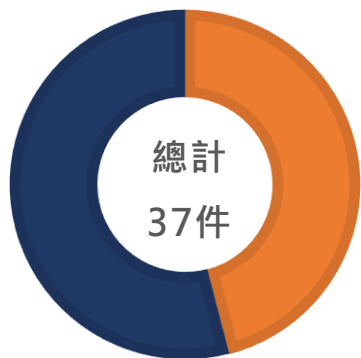
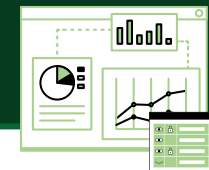
精密量測治具開發  
精密度匹配業主需求



# 全方位售服及技術支持



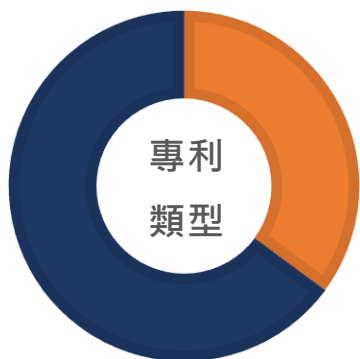
# 創新能力-專利佈局



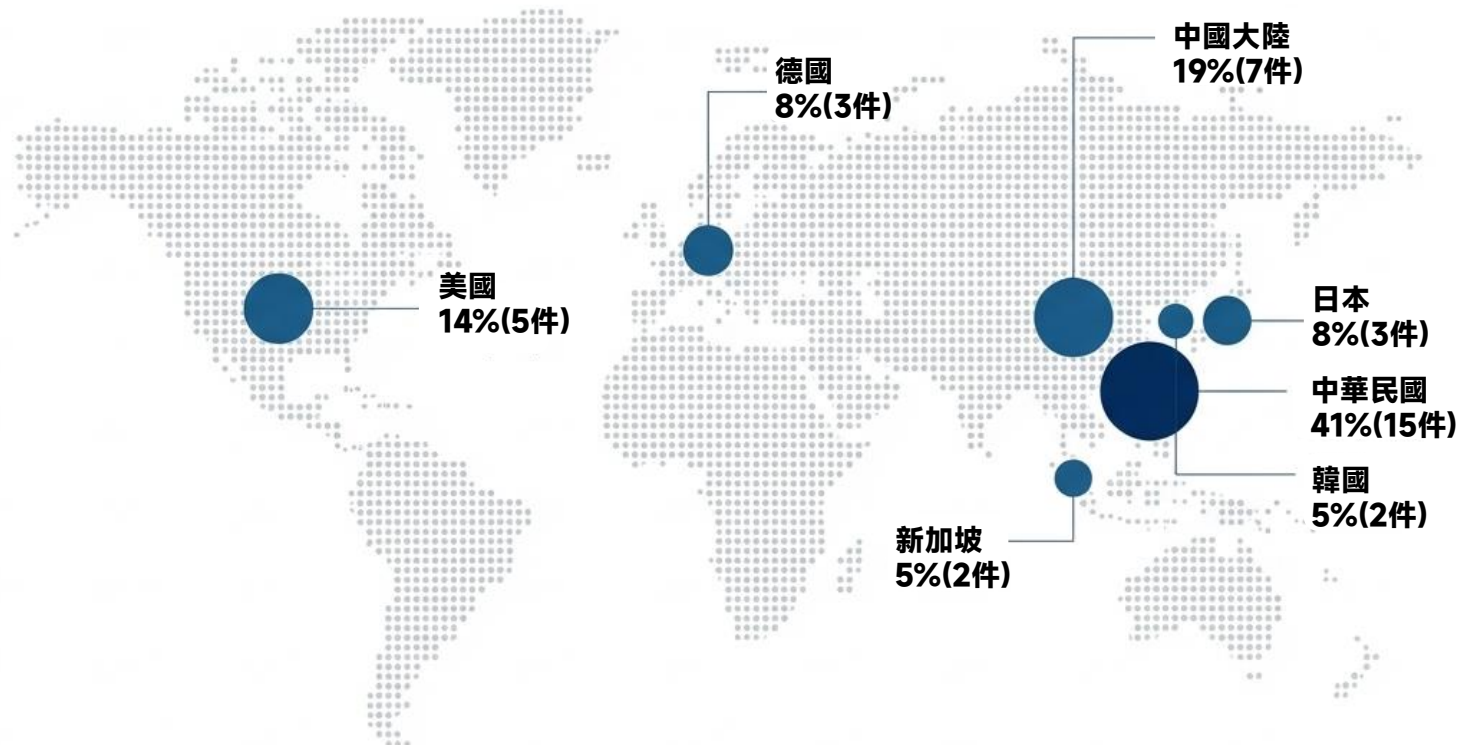
- 有效專利 46%(17件)
- 審查中專利 54%(20件)

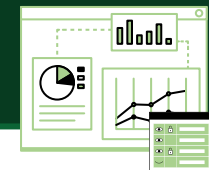
有效專利：發明4件、新型13件

審查中專利：發明20件



- 新型專利 35%(13件)
- 發明專利 65%(24件)





## 投入資源佈局未來

### 第一主軸：人才資源戰略

#### 內部深耕 | 建構專業人才庫

強化技術職能以打造核心優勢；建置知識庫加速經驗傳承。

#### 外部引水 | 延伸學研合作

深化產學對接以穩固人才儲備；透過協作平台接軌前瞻趨勢。

### 創新能力- 資源投注

### 第二主軸：研發動能強化

#### 內部精進 | 優化執行效能

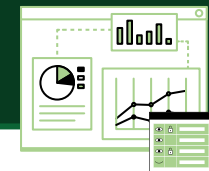
持續深耕核心設計能力，提升解決方案品質。

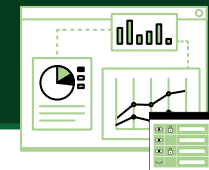
#### 外部賦能 | 擴大供應商策略合作

整合外部技術資源加速研發；優化供應鏈以提升協作效率。

# 04.聚賢永續行動







## 環境關懷

綠色製程  
低碳通勤  
能源轉換  
推動無紙化  
永續發展委員會



## 公司治理

營業秘密  
性別平等  
激勵獎金  
EAP制度  
在職進修



## 社會加值

公益假  
樂活假  
公益信託  
美麗台灣  
產學合作





## 以卓越技術驅動產業升級，以永續發展實踐企業承諾

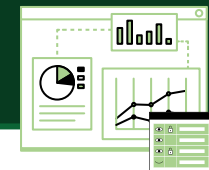


榮獲 **2024 MM ESG Award**



供應商 ESG 聯合提案：  
卓越影響獎 **伍獎**





以卓越技術驅動產業升級，以永續發展實踐企業承諾

## 【創新研發 Innovation】



2025 台灣創新技術博覽會 (TIE)  
發明競賽 銅牌

## 【永續經營 ESG】



2025 第十八屆台灣企業永續獎 (TCSA)  
企業永續報告書 銅獎

# 05.業務發展暨財務績效





## 產業趨勢與市場預測

### 市場規模與增長預測



### 關鍵技術創新



先進封裝與Chiplet  
異質整合



亞2nm節點採用  
EUV顯影技術與  
GAA電晶體



第三代半導體材料  
SiC和GaN應用增長

### 終端應用驅動



汽車電子



高性能計算



網絡通訊

### 供應鏈與區域發展



區域性在地化生產

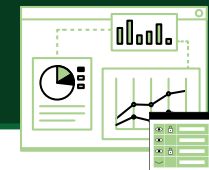


供應鏈韌性

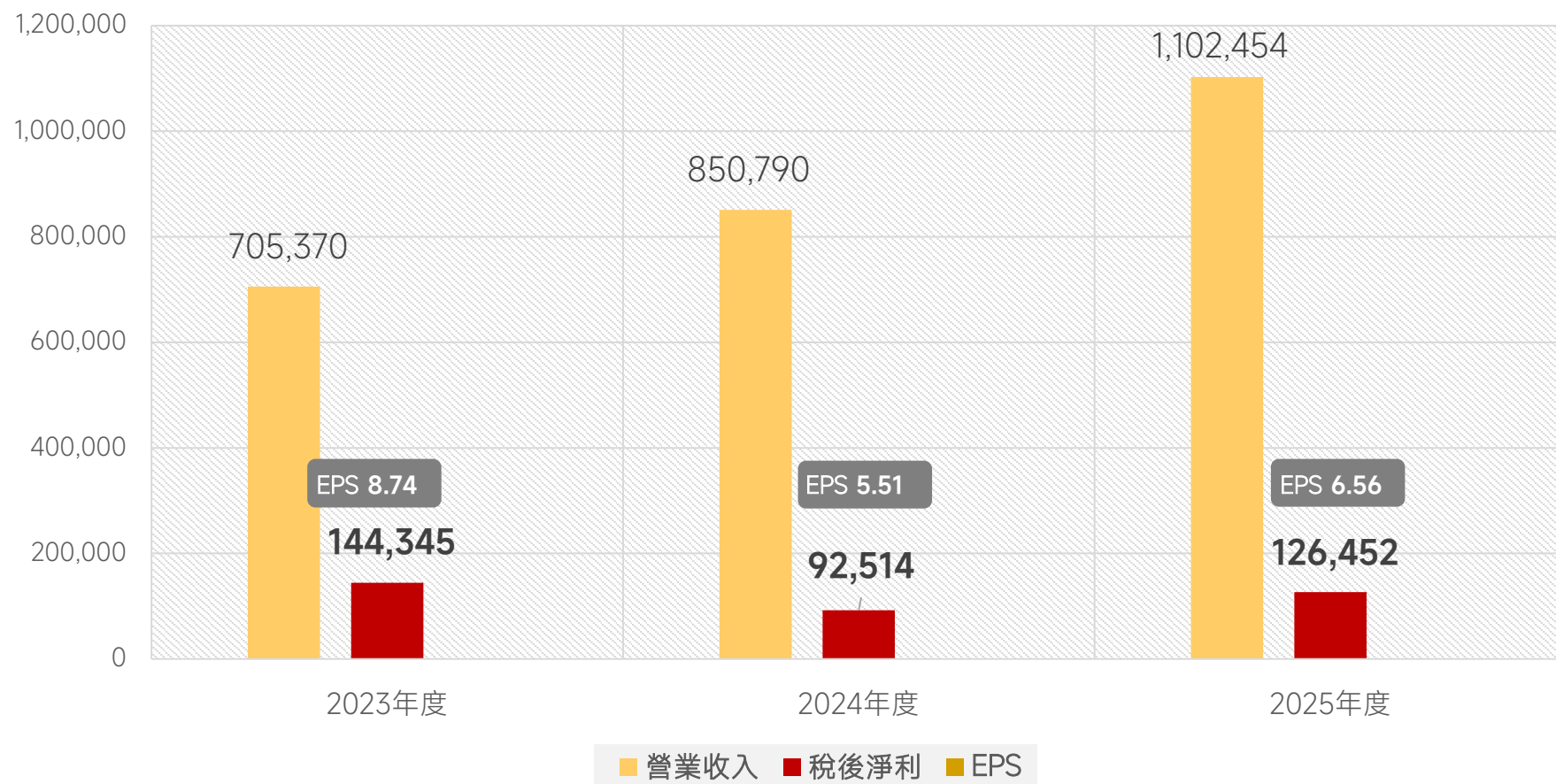


晶圓產能管理

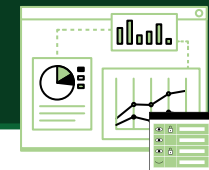
資訊來源：參考國內外半導體及技術報導



## 2023~2025年度經營績效



註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證



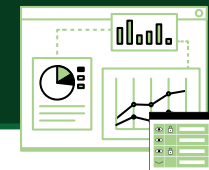
## 綜合損益表

2023~2025年度

單位：新台幣仟元

會計項目/期間	2023年度	2024年度	2025年度	YOY(%)
營業收入	705,370	850,790	1,102,454	29.58%
<b>毛利率</b>	<b>39.93%</b>	<b>31.26%</b>	<b>27.52%</b>	<b>(11.96)%</b>
營業費用	102,357	127,155	149,874	17.87%
營業利益	179,304	138,813	153,593	10.65%
營業利益率	25.42%	16.32%	13.93%	(14.64)%
稅後淨利	144,345	92,514	126,452	36.68%
純益率	20.46%	10.87%	11.47%	5.52%
<b>EPS(元)</b>	<b>8.74</b>	<b>5.51</b>	<b>6.56</b>	<b>19.06%</b>
權益報酬率	34.82%	18.67%	18.72%	0.27%

註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證



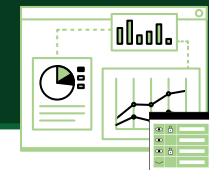
## 資產負債表

2023~2025年度

單位：新台幣仟元

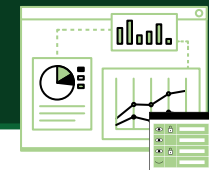
會計項目/期間	2023年度	2024年度	2025年度	YOY(%)
現金及約當現金	255,325	208,743	610,574	192.50%
應收帳款	79,003	192,543	99,413	(48.37)%
<b>存貨(含合約資產)</b>	<b>340,996</b>	<b>400,201</b>	<b>486,005</b>	<b>21.44%</b>
總資產	754,999	1,008,599	1,483,072	47.04%
流動負債	253,107	340,945	478,222	40.26%
非流動負債	20,753	157,763	163,916	3.90%
負債總計	273,860	498,708	642,138	28.76%
重要財務指標				
負債比	36.27%	49.45%	43.30%	(12.44)%
<b>存貨周轉率(次)</b>	<b>1.29</b>	<b>1.58</b>	<b>1.80</b>	<b>13.92%</b>
<b>應收帳款週轉率(次)</b>	<b>6.23</b>	<b>6.27</b>	<b>7.55</b>	<b>20.41%</b>

註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證



## 採季配股利方式，兼顧成長與穩定收益

年度	每股現金股利 / 盈餘配發率
2024年第一季	0.50元
2024年第二季	0.50元
2024年第三季	0.59元
2024年第四季	1.20元
<b>2024年度合計</b>	<b>2.79元 / 51%</b>
2025年第一季	0.65元
2025年第二季	0.74元
2025年第三季	0.75元
2025年第四季	1.60元
<b>2025年度合計</b>	<b>3.74元 / 59%</b>



## 研發費用占營收比重

單位：新台幣仟元

年度	2023年度			2024年度			2025年度		
公司名稱	研發費用	營業收入	比重%	研發費用	營業收入	比重%	研發費用	營業收入	比重%
聚賢研發	11,873	705,370	1.68	13,018	850,790	1.53	21,911	1,102,454	1.99
漢科	19,134	4,438,601	0.43	19,497	5,487,092	0.36	17,445	5,245,806	0.33
銳澤	—	1,779,726	0.00	4,721	1,951,312	0.24	10,932	2,564,418	0.43

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之財務報告

# 謝謝您的聆聽

Q & A



官方網站



2024 永續報告書

**永續報告書下載**

**GENIDEAS<sup>®</sup>**



反省



創新



即時



共好